

1-6 残銅／残余銅 / Residual copper

1-6-1 異物起因（残銅）／杂物起因（残余銅）／ Caused by foreign objects(residual copper)

1-6-1-1 スカム・ヘドロ残銅／余膜、汚泥的残余銅 / Scum or sludge-like residual copper

【特徴】 導体間隔部や非導体部に、導体表面と同一高さの比較的丸みを帯びた、或いはスカム片形状の残銅

【特征】 在导线间隔部或非导线区有偏圓型或片状的残余銅。

【Characteristics】 A relatively round or a scum-like residual copper of the same height as that of the conductor on conductors or a non-conductive area.

【原因・判断ポイント・発生工程】 DFR 剥離工程で、ヘドロや露光した DFR 剥離片が付着して ET レジストとなった為出来たもの（現像～ET 工程）

【原因、判断要点、发生工序】 在 DFR 退膜工序附着汚泥、或曝光的 DFR 剥離片成为 ET 剂所引起的（显影～ET 工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】 Sludge or an exposed dry film debris adhered on a panel in the developing process acts as an etching resist causing the defect. (Development - etching process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

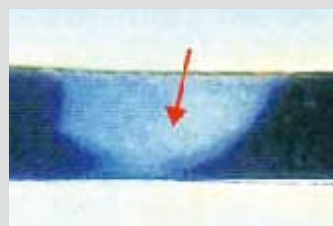
【Comments】
Magnification: ×

1-6-1-2 プリプレグ残銅／B 片屑的残余銅 / Residual copper under prepreg debris

【特徴】 多層板の非導体部に、プリプレグ屑を被った状態で残っている、銅箔残銅

【特征】 在多层板的非导线区覆盖 B 片屑的残余銅。

【Characteristics】 Residual copper foil covered by prepreg debris on the non-conductive area of a multilayer board



【コメント】
プリプレグの下に積層板の銅箔がのこっている
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
在层压板的铜箔下面存在 B 片屑
显微镜倍率 ×

【Comments】
Left photo is a Copper foil of laminate remaining under prepreg debris
Magnification: ×